

格科微有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“12英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人民币3,507,576,091.81元（以下简称“募集资金”），上述资金于2021年8月13日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0727号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

2021年8月13日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》。针对不同的募投项目实施主体，本公司及本公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及本公司之子公司格科微电子(香港)有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体情况详见公司于2021年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目的情况

2021年8月13日，公司披露的《格科微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露了募集资金投资项目及募集资金使用计划。2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意本公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意使用募集资金向全资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目建设。详见公司于2021年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-001）和《格科微有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-002）。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金
1	12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目	6,376,198,800.00	3,507,576,091.81
2	CMOS 图像传感器研发项目	583,801,200.00	-

合计	6,960,000,000.00	3,507,576,091.81
----	------------------	------------------

截至2023年6月30日公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-049）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及余额情况

截至2023年12月25日，“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”累计投入351,194.85万元，募集资金账户余额1,379.92万元。具体使用及余额情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金	募集资金账户余额
12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目	350,757.61	351,194.85	1,379.92

注：在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了上述资金余额。上述资金余额将用于支付募投项目相关尾款。

鉴于公司募集资金投资项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”已达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。待付款项全部结清后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、 本次募投资项目结项的具体情况

公司“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投资项目进行结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年12月26日